



Ball-Wedge Bonder 5810

Bond System

Drahttypen	Golddrähte 17,5-50µm auf 2"-Spule
Bondkopf	Ball-Wedge für Golddrähte Standardkapillare 16mm Länge (optional 19mm)
Ultraschall System	F&S US System 68kHz (optional 106, 120, 140kHz)

Maschinen Basis

Achsen

- Arbeitsbereich X/Y-Achse 200x150mm
- Schrittauflösung 1µm programmierbar
- Programmierbare Z-Achse mit 100mm Hub

Hardware

- Dual-Core PC mit Windows OS Ethernet,
- USB 2.0/3.0, LCD Farbdisplay 22"
- GigE-CMOS-Farbkamera
- Netzwerkfähig mit Programm-Archivierung

Software

- Einzelbonds bis komplexe Programme,
- Loopformen in Bibliotheken speicherbar
- Optionale Bilderkennung

Steuerung

- Hochleistungseembedded ARM-System mit Echtzeitbetriebssystem für Präzisions-Bahnkurven
- 1 Draht / Sekunde

Platziergenauigkeit +/- 5µm @ 3 sigma, inkl. Tool/ohne Draht auf F&S Bondtec Standard-Substrat

Wiederholgenauigkeit +/- 3 µm @ 3 sigma, inkl. Tool/ohne Draht auf F&S Bondtec Standard-Substrat

Loophöhengenaugigkeit +/- 5µm @ 3 sigma, bei Dünndraht 5830 mit 25µm Aluminium Draht auf F&S Bondtec Standard-Substrat

Die 58xx Serie:

Die Ball-Wedge-Variante der automatischen Drahtbonder unserer Serie 58xx mit austauschbaren Bondköpfen.

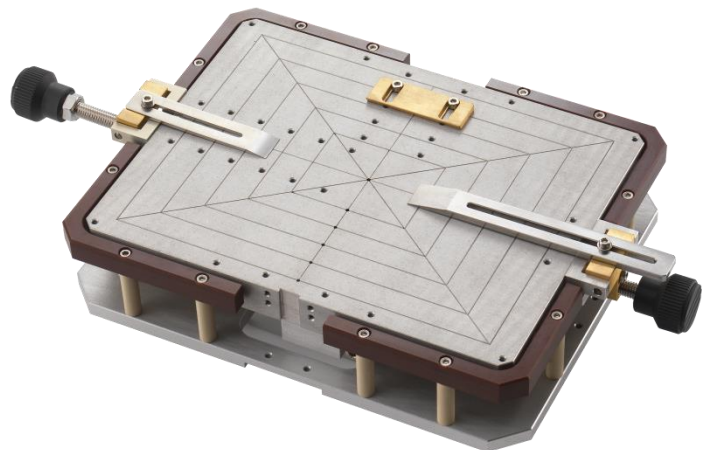
Ideal geeignet für die Fertigung, da automatisch einsetzbar mit einer Bondgeschwindigkeit von typisch ein Draht pro Sekunde. Bauteilwechsel durch Bediener, der Bondablauf ist dank eingebauter Bilderkennung völlig bedienerfrei.

Einzelbonds sind in Sekunden herstellbar, daher auch perfekt für R&D, Pilot-fertigung und Serienfertigung mit mittleren Los-größen geeignet!

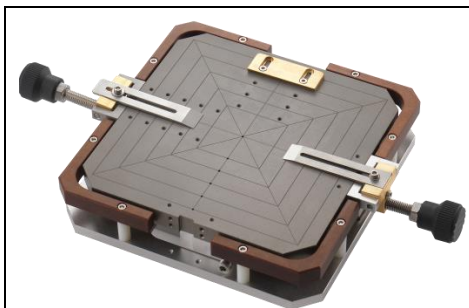
Abmessung B x T x H – 92 x 71 x 65 cm, Gewicht ca. 80kg
Anschlüsse 100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA,
Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
Heizung Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Substrathalter

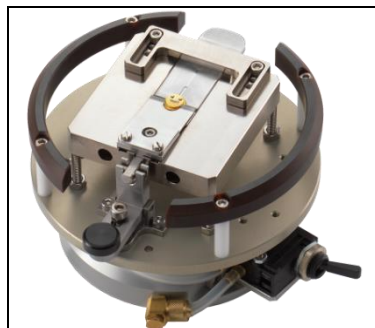
Standard-Substrataufnahme
für Bauteile bis 8x6" mit
Vakuum und mechanischer Klemmung



Optional:



Vakuumaufnahme 6x6"
mit mechanischer Klemmung



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanische Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a
A-5280 Braunau am Inn
Tel.: +43-7722-67052-8270
Fax: +43-7722-67052-8272
Mail: info@fsbondtec.at
Web: www.fsbondtec.at

Hilpert electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:
Hilpert electronics AG
Täferenstrasse 29
5405 Baden-Dättwil
Schweiz / Suisse
Tel: +41 56 483 25 25
Fax: +41 56 483 25 20
Mail: office@hilpert.ch
Web: www.hilpert.ch

